

tSML - LWL Breakoutmodul 19"/0.5HE gerade 4x MPO/MTP[®] m. Pins/16x LC Duplex 50/125 μ OM4
40GbE



tSML - tde Semi Modular Link

tSML ist ein modular aufgebautes Verkabelungssystem, das aus zwei Kernkomponenten besteht: Modul und Trunkkabel. Es handelt sich hierbei um vorkonfektionierte getestete Systemkomponenten, die vor Ort insbesondere in Rechenzentren eine Plug & Play Installation innerhalb kürzester Zeit ermöglichen. Die LWL und TP Module können mit ihren Abmessungen von 19 " 0,5HE zusammen innerhalb einer Höheneinheit mit sehr hoher Portdichte kombiniert eingesetzt werden. Bis zu 96x LWL Duplex bzw. 48x RJ45 Ports sind so auf 1HE möglich. Das Herz des Systems sind die rückseitigen MPO/ MTP[®] und Telco Steckverbinder, über die mindestens 6 Ports mit 10GbE bzw. GbE Performance auf einmal verbunden werden können.



tde[®] trans data elektronik GmbH

Hausanschrift:

Lingener Str. 2
D-49626 Bippen/Ohrte
Tel.: +49 5435 9511 0
Fax.: +49 5435 9511 32

Vertriebsbüro:

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46
D-44135 Dortmund
Tel.: +49 231 914 36 99
Fax.: +49 231 914 31 29

info@tde.de | www.tde.de

tSML - LWL Breakoutmodul 19"/0.5HE gerade 4x MPO/MTP[®] m. Pins/16x LC Duplex 50/125µ OM4
40GbE

Technische Daten

Die Endflächen der Steckverbinder sind mittels Lasercleaving und Maschinenpolitur optimiert. Die MPO/MTP[®]Stecker besitzen einen definierten Faserüberstand von 1 - 3.5µ. Die Max. Höhendifferenz benachbarter Fasern beträgt 0.2µm und die aller Fasern 0.3µm. Alle Systemkomponenten (Module, Trunkkabel und Patchkabel) sind zur Erreichung der Performance speziell aufeinander abgestimmt. Das Modul ist beschriftet mit fortlaufender Seriennummer und Artikelnummer. Die Module sind ROHS-konform.

Eingang	4 x MPO/MTP [®] Male Kupplung (magenta) frontseitig
Ausgang	16 x LC Duplex Kupplungen (magenta) frontseitig
Tests	Interferometermessung, Einfüge- und Rückflußdämpfungsmessungen und visuelle Endkontrolle; alle Messwerte sind elektronisch abrufbar
	QS-Managementsystem nach ISO 9001, ISO 14001 und TL 9000

tSML - LWL Module 19"/ 0.5HE

Gehäuse	Edelstahl
Frontplatte	Edelstahl
Abmessungen	19", 0.5 HE, Tiefe 11 cm

LWL Adapter

Typ	MPO/MTP [®]
Anwendung	Multimode OM4
Bauform	ohne Flansch
Einbauform	SC Simplex
Orientierung	Typ A, Key up/down
Farbe	Magenta
Material	Kunststoff
Hülse	--
Klappe	--
Standards	IEC 61754-7 TIA 604-5
Hersteller	US Conec

LWL Steckverbinder

Die Endflächen der Steckverbinder sind mittels Lasercleaving und Maschinenpolitur optimiert. Die MPO/MTP[®] Stecker besitzen einen definierten Faserüberstand von 1 - 3.5µ. Die Max. Höhendifferenz benachbarter Fasern beträgt 0.2µm und die aller Fasern 0.3µm.

tSML - LWL Breakoutmodul 19"/0.5HE gerade 4x MPO/MTP[®] m. Pins/16x LC Duplex 50/125 μ OM4
40GbE

Stecker

Stecker	MPO/MTP [®] Male Push Pull Verriegelung mit Elite Pins (magenta)
Ferrule	12 Faser MM Elite [®] Ferrule, PPS
Tüllenfarbe	Schwarz
Hersteller	tde/US Conec

Optische Performance

Faser	Typ	Wellenlänge	Einfügedämpfung typ.	Einfügedämpfung max.	Rückflussdämpfung min.
50/125 μ OM4	MPO/MTP [®]	850 nm	\leq 0.12 dB	0.25 dB	35 dB

LWL Adapter

Typ	LC Duplex
Anwendung	Multimode OM4
Bauform	One-Piece ohne Flansch
Einbauform	SC Simplex
Farbe	Magenta
Material	Kunststoff
Hülse	Keramik
Klappe	--
Hersteller	tde

LWL Steckverbinder

Stecker Typ	LC Unibody Simplex
Gehäuse	Kunststoff, Magenta
Ferrule	Keramik, Axial Gefedert
Ferrul-Bohrung	126 μ
Steckzyklen	1.000
Betriebstemperatur	-40°C bis +75°C
Zugentlastung bis	100 N
Hersteller	tde

Optische Performance

Faser	Typ	Wellenlänge	Einfügedämpfung typ.	Einfügedämpfung max.	Rückflussdämpfung min.
50/125 μ OM4	LC	850 nm	\leq 0.07 dB	0.15 dB	35 dB

tSML - LWL Breakoutmodul 19"/0.5HE gerade 4x MPO/MTP[®] m. Pins/16x LC Duplex 50/125µ OM4
40GbE

LWL Faser

Typ	Draka OM4 50/125µm biegeoptimierte Multimode Faser (C32)		
-----	--	--	--

Standards und Normen	IEC 60793-2-10 Kategorie A1a.3	ITU G.651.1	TIA/EIA-492 AAAD
	ISO/IEC 11801 Kategorie OM4	EN 60793-2-10 Kategorie A1a.3	ANSI/TIA/EIA-568.C
	ISO/IEC 24764	EN 50173-1 Kategorie OM4	IEEE 802.3

Dämpfung gemäß IEC 60793-1-40

Maximale Dämpfung des Kabels bei 850 nm	≤ 3.0 dB/km
Maximale Dämpfung des Kabels bei 1300 nm	≤ 1.0 dB/km
Maximale Dämpfung der Faser (nur Planungswert) bei 850 nm	≤ 2.5 dB/km
Maximale Dämpfung der Faser (nur Planungswert) bei 1300 nm	≤ 0.8 dB/km
Inhomogenität des OTDR-Schriebs für zwei beliebige 1000 Meter Längen	Max. 0.1 dB/km

Bandbreite und Brechungsindex gemäß IEC 60793-1-41

OFL-Wert bei 850 nm	≥ 3500 MHz*km
OFL-Wert bei 1300 nm	≥ 500 MHz*km
Effektive Modale Bandbreite (EMB) Effektive Modale Bandbreite ist nachgewiesen durch Differential Mode Delay (DMD) Messung gemäß IEC 60793-1-49	≥ 4700 MHz*km
Gruppen-Brechungsindex bei 850 nm	1.482
Gruppen-Brechungsindex bei 1300 nm	1.477

Fasereigenschaften gemäß IEC 60793-1

Attribute	Messmethode	Grenzwerte
Kerndurchmesser	IEC/EN 60793-1-20	50 ± 2 µm
Manteldurchmesser	IEC/EN 60793-1-20	125.0 ± 1.0 µm
Mantel-Unrundheit	IEC/EN 60793-1-20	≤ 0.7%
Kern-Unrundheit	IEC/EN 60793-1-20	≤ 5%
Kern-Mantel Konzentritätsfehler	IEC/EN 60793-1-20	≤ 1 µm
Primärcoating-Durchmesser - ungefärbt	IEC/EN 60793-1-21	242 ± 5 µm
Primärcoating-Durchmesser - gefärbt	IEC/EN 60793-1-21	250 ± 15 µm

tSML - LWL Breakoutmodul 19"/0.5HE gerade 4x MPO/MTP[®] m. Pins/16x LC Duplex 50/125 μ OM4
40GbE

Primärcoating-Unrundheit	IEC/EN 60793-1-21	$\leq 5\%$
Primärcoating-Mantel Konzentritätsfehler	IEC/EN 60793-1-21	$\leq 6 \mu\text{m}$
Zugfest-Stärke	IEC/EN 60793-1-30	$\geq 0.7 \text{ GPa}$ ($\approx 1\%$)
Typische durchschnittliche Abziehkraft	IEC/EN 60793-1-32	1.7 N
Abziehkraft (Spitzenwert)	IEC/EN 60793-1-32	$1.3 \text{ N} \leq F_{\text{peak.strip}} \leq 8.9 \text{ N}$
Numerische Apertur	IEC/EN 60793-1-43	0.200 ± 0.015

Artikelvarianten & Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
TSML-M16LCAD/MPP09E	tSML - LWL Breakoutmodul 19"/0.5HE gerade 4x MPO/MTP [®] m. Pins/16x LC APC Duplex 9/125 μ OS2 40GbE
TSML-M16LCD/MPP50G3	tSML - LWL Breakoutmodul 19"/0.5HE gerade 4x MPO/MTP [®] m. Pins/16x LC Duplex 50/125 μ OM3 40GbE
TSML-M16LCD/MPP50G4	tSML - LWL Breakoutmodul 19"/0.5HE gerade 4x MPO/MTP [®] m. Pins/16x LC Duplex 50/125 μ OM4 40GbE